

北京赛微电子股份有限公司

关于全资子公司土地及其附着物抵押解除的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年7月18日，北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司向工商银行申请并购贷款的议案》、《关于全资子公司向工商银行申请项目贷款的议案》，同意公司向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行（现已更名为“中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区支行”，以下简称“工商银行”）申请不超过9,760万元的并购贷款，用于支付公司收购北京镭航世纪科技有限公司（以下简称“镭航世纪”）合计51%股权的部分并购款，公司以全资子公司北京耐威时代科技有限公司（以下简称“耐威时代”）位于北京经济技术开发区路东区F2M3地块工业用地及在建工程提供抵押担保；同意公司全资子公司耐威时代向工商银行申请不超过人民币3,000万元的项目贷款，用于继续建设耐威时代惯性及卫星导航产品研发生产基地，耐威时代亦以上述土地及在建工程提供抵押担保。具体内容详见公司于2017年7月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

截至2020年底，公司及全资子公司耐威时代已归还上述贷款的全部本息。2021年2月2日，抵押人（耐威时代）与抵押权人（工商银行）在北京经济技术开发区不动产登记中心办理完毕了抵押权注销登记手续，该笔土地及其附着物抵押正式解除。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2021年2月2日